

IE-PCB-SPM-P-180-THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SPElink®

**Гнезда для печатной платы – однопарный Ethernet**

Однопарный Ethernet – это технология, требующая использования только одной пары кабелей для передачи данных и питания.

Получаемые преимущества сделают однопарный Ethernet предпочитаемой сетью на уровне поля и за его пределами.

Преимущества однопарного Ethernet

- Последовательность: однопарный Ethernet обеспечивает унифицированное прохождение информации на основе Ethernet от датчика в облачную среду
- Готовность к будущему: основная технология для Индустрии 4.0 и Интернета вещей
- Гибкость: рабочий диапазон до 1000 м и возможности передачи со скоростью до 1 Гбит/с обеспечивают универсальность использования
- Техническая эффективность: меньший вес, экономия используемого пространства и более простая установка

Основные данные для заказа

Версия	Встраиваемый штекер, Вставка печатной платы M8, Гнездо, Соединение под пайку, Штыревой контакт, IP67, с корпусом, Соединение THT/THR под пайку, 180°, Количество полюсов: 2
Заказ №	2735920000
Тип	IE-PCB-SPM-P-180-THR
GTIN (EAN)	4050118820164
Кол.	100 Шт.

IE-PCB-SPM-P-180-THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	14,5 мм	Глубина (дюймов)	0,571 inch
Высота	24 мм	Высота (в дюймах)	0,945 inch
Ширина	10,1 мм	Ширина (в дюймах)	0,398 inch
Масса нетто	3 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...85 °C
---------------------	----------------

Упаковка

Длина VPE	330 мм	VPE с	330 мм
Высота VPE	49 мм		

Системные характеристики

Вид защиты	IP67, с корпусом	Вид соединения	Соединение под пайку, Штыревой контакт
Категория	T1-B	Категория эксплуатационных характеристик	T1-B
Количество полюсов	2	Монтаж на печатной плате	Соединение THT/THR под пайку
Серия изделия		Техпроцесс пайки	Пайка оплавлением сквозных отверстий (Reflow), Пайка вручную, Пайка волной припоя
Угол вывода	Промышленный Ethernet 180°	Циклы коммутации	≥ 100

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 63171-5
---------------------------	-------------

Электрические свойства

Номинальное напряжение	72 V	Номинальный ток	4 A
Прочность изоляции	≥ 500 MΩ	Электрическая прочность, контакт / контакт	1000 V DC
Электрическая прочность, контакт / экран	2250 V DC		

Данные о материалах

Изоляционный материал	LCP	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Прочность изоляции	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Материал контакта	Сплав меди	Поверхность контакта	Ni/Au
Рабочая температура, мин.	-40 °C	Рабочая температура, макс.	85 °C

Классификации

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

IE-PCB-SPM-P-180-THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

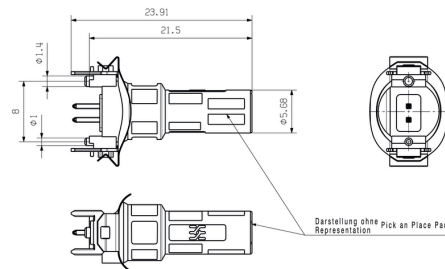
Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

www.weidmueller.com



Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.